

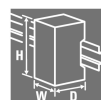
CH20M67 B BUS GGY/BK 2019**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podstawowy element modułowej obudowy CH20M oferuje szereg zalet, które sprawiają, że jest to doskonały wybór dla Państwa projektów. Dzięki specjalnym wycięciom na magistrale i styki FE jest szczególnie elastyczny i łatwy w adaptacji.

Kolejnym punktem zapewniającym wartość dodaną jest opcja druku laserowego na obudowie, która zapewnia wysoką precyzję i możliwości w zakresie indywidualnego designu. Dostępna jest również szeroka gama kolorystyczna, dzięki czemu można zaprojektować obudowę całkowicie zgodnie z życzeniem klienta.

Obudowa CH20M jest również dopasowana do standardowych szyn montażowych, co ułatwia instalację i integrację z istniejącymi systemami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M grafitowy szary, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 67.5 mm
Nr zam.	1413780000
Typ	CH20M67 B BUS GGY/BK 2019
GTIN (EAN)	4050118214901
Ilość	4 szt.

CH20M67 B BUS GGY/BK 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	108 mm	Głębokość (cale)	4.252 inch
Wysokość	109.3 mm	Wysokość (cale)	4.3031 inch
Szerokość	67.5 mm	Szerokość (cale)	2.6575 inch
Masa netto	44.55 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C	Zakres temperatury stosowania	-40...120 °C
Wilgotność	5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Właściwości zespołu

Liczba gniazd dla złącz żeńskich zamontowanego podzespołu, maks.	18	Liczba płytek drukowanych, maks.	3
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks	3	Liczba biegunów, maks.	72
Wysokość komponentów na płycie drukowanej (zastosowanie 1 płytek drukowanych), maks.	61.1 mm	Wysokość komponentów na płycie drukowanej (zastosowanie 2 płytek drukowanych), maks.	57.2 mm
Wysokość komponentów na płycie drukowanej (zastosowanie 3 płytek drukowanych), maks.	34.7 mm	Rodzaj montażu płytki drukowanej	dwustronne

Testy mechaniczne

Zgodnie ze standardem	DIN EN 61373:1999 (udary i wibracje)	
Warunki testu	trzy obudowy zamontowane w rzędzie, 200g dodatkowej masy na PCB, trzy PCB zamontowane	
Niezawodne osie	X, Y, Z	
Test zderzeniowy	Ogólne wskazówki dotyczące testowania	Wszystkie testy mechaniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
	Kategoria testu	1
	Liczba uderzeń na oś	3 w kierunku dodatnim i ujemnym
	Czas trwania zderzenia	30 ms
	Przyspieszenie poziome	30.00 m/s ²
	Przyspieszenie pionowe	30.00 m/s ²
	Przyspieszenie wzdłużne	50.00 m/s ²
Test wibracyjny	Kategoria testu	1B
	Czas trwania testu	5 godzin na oś
	Skuteczne przyspieszenie	7.9 m/s ²

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	PA 66 GF 30
grupa materiałów izolacyjnych	I	Powierzchnia	nieobrobiony

CH20M67 B BUS GGY/BK 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Materiał podstawowy	tworzywo sztuczne	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI
---------------------	-------------------	---------------------------------------	-----------

Dane ogólne

Barwny	grafitowy szary	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Szyna montażowa	TS 35	Tabela kolorów (podobny)	RAL 7024
możliwość zalewania	Nie		

Testy termiczne

Testy termiczne	Ogólne wskazówki dotyczące testowania	Wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.	
	Warunki testu	siedziom obudów zamontowanych w rzędzie - brak odstępu	
	Badane osie	poziomy	
	Temperatura otoczenia	80 °C	
	Rozpraszanie mocy, maks.	5.7 W	
	Temperatura otoczenia	60 °C	
	Rozpraszanie mocy, maks.	8.1 W	
	Temperatura otoczenia	40 °C	
	Rozpraszanie mocy, maks.	10.8 W	
	Temperatura otoczenia	20 °C	
	Rozpraszanie mocy, maks.	13.6 W	

Właściwości komponentu

Kolor stopki przyczepianej	czarny	Wycięcie w obszarze stopki zatraskowej	Styk magistrali, styk jako przygotowanie do nieujęty w zestawie!
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks 3			

Projekt – wymagania IN

tolerancja konturu płytki drukowanej	±0,1 mm	grubość płytki drukowanej	1.6 mm
tolerancja grubości płytki drukowanej	±0,15 mm		

Opcje indywidualizacji

Możliwość zastosowania etykiet specjalnych	Tak	Proces zamówienia na życzenie klienta	Patrz wytyczne w sekcji do pobrania
Warianty kolorystyczne	Więcej na życzenie	Możliwości obróbki	Obróbka laserowa

Ważna informacja

Informacje produktowe	Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.		
-----------------------	--	--	--

Klasyfikacje

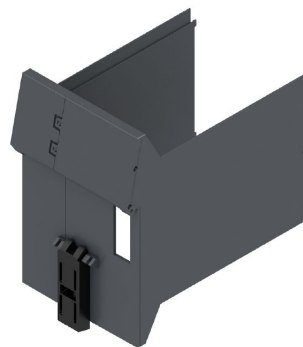
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Rysunki

Zdjęcie produktu

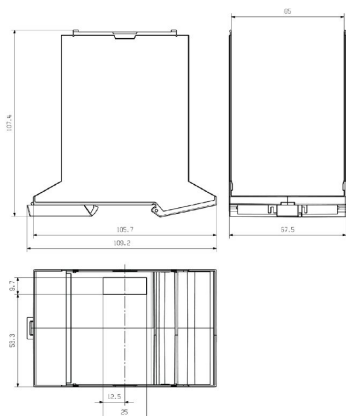


Zalety produktu



Element bazowy z wycięciem BUS

Rysunek wymiarowy



Akcesoria

blok stykowy magistrali - kołnierz lutowany



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

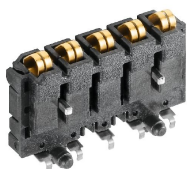
Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięć w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	Wersja
Nr zam.	1155900000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942381	kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów:
Ilość	300 ST	5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, pozłacany, czarny
Typ	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	Wersja
Nr zam.	1155890000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942527	kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów:
Ilość	78 ST	5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, pozłacany, czarny

Akcesoria

blok stykowy magistrali - środkowy kołnierz lutowany



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięć w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3....	Wersja
Nr zam.	1155880000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942305	kołnierz środkowy lutowany, Połączenie lutowane THT/THR,
Ilość	300 ST	Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, pozłacany, czarny
Typ	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3....	Wersja
Nr zam.	1155870000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942510	kołnierz środkowy lutowany, Połączenie lutowane THT/THR,
Ilość	78 ST	Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, pozłacany, czarny